



## 講演募集

### 第65回 半導体集積回路技術 シンポジウム

平成15年12月18日(木)・19日(金)  
機械振興会館ホール  
東京都港区芝公園 3-5-8  
Tel. 03-3434-8216

主催：  
電気化学会電子材料委員会

協賛予定学会：  
応用物理学会、高分子学会、  
精密工学会、電気学会、  
電子情報通信学会、日本印刷学会、  
日本化学会、日本金属学会、  
日本セラミックス協会、日本写真学会、  
日本表面科学会、日本真空協会

第65回半導体集積回路シンポジウムを下記の要領で開催いたします。奮ってご参加下さい。

日時：平成15年12月18日(木)・19日(金)  
会場：機械振興会館ホール  
東京都港区芝公園 3-5-8

本シンポジウムはわが国の半導体・集積回路技術分野における特色ある講演会として発足以来、今回65回を迎えることになりました。この間、この分野の学問、技術の発展に大きく貢献して参ったものと自負しております。本シンポジウムは、参加者全員で最近の研究結果の発表・質疑討論を行えるよう企画・実施されており、特色の一つとなっております。今後もこのシンポジウムをこれまで以上にこの分野の研究・開発に従事する方にとって、良い討論と意見交換の機会にたく存じます。

#### 発表論文募集要項

##### 1) 募集論文の分野

今回の特集テーマは「高速LSIデバイス技術、およびそれに必要なプロセス技術」といたしております。今、注目を集めているSiGeひずみSOIや低抵抗ゲート・拡散層形成技術などのフロントエンド技術、新規なCu配線、低誘電率絶縁膜形成技術などのバックエンド技術、さらには3次元集積化システムなど、幅広い分野のデバイス・プロセス技術について議論したいと考えます。

なお一般講演の中からAward Paperの選出を行っております。分野の研究者及び開発技術者には、奮って投稿下さるようお願い致します。

招待講演として、以下に示す方々の講演を予定しております。

##### < 高速デバイス関連技術 >

1. ひずみSOI - CMOS技術  
水野智久(MIRAI - ASET)
2. 次世代LOGIC向けトランジスタの高性能化  
須黒恭一(東芝セミコンダクタ)
3. 先端CMOSデバイス向けSiON絶縁膜技術(仮題)  
由上二郎(ルネサステクノロジ)
4. 浅い接合形成技術(交渉中)

##### < 3次元集積回路およびシステム技術 >

1. 3次元集積回路技術と応用システム  
小柳光正(東北大)

##### < Cu & Low-k配線関連技術 >

1. 超臨界流体中での配線形成技術  
近藤英一(山梨大)

2. Cu / Low - k配線における洗浄技術  
青木秀充(NECエレクトロニクス)
3. 65nm ノード以降のSoC技術へ向けた高信頼性Cu/VLK(k<2.3)多層配線  
杉浦巖(富士通研究所)

##### 2) 締切り時期

講演申込締切 9月 24日(水)

講演題目、発表者氏名(講演者に 印)、勤務先、連絡先を明記の上、お申し込みください。(E-mail可)

講演論文原稿締切 11月 25日(火)

図表を含めカメラレディの原稿7,000字程度で期限内に提出下さい。講演時間は討論を含め1件25分の予定。

##### 3) 講演申込先

電気化学会電子材料委員会

〒102-0074東京都千代田区九段南4-8-30

アルス市ヶ谷202

TEL:03-3234-4213, FAX:03-3234-3599

E-mail [ohnishi@electrochem.jp](mailto:ohnishi@electrochem.jp)

##### 4) 参加登録費(講演論文集1部含む)

\* 予約参加費(12月12日締切)、( )内は当日登録

	2日通し参加	1日のみ参加
会員	¥20,000(¥22,000)	¥14,000(¥15,000)
会員外	¥22,000(¥24,000)	¥15,000(¥16,000)
大学関係	¥5,000(¥6,000)	¥5,000(¥6,000)

##### 電気化学会電子材料委員会

委員長：小田俊理(東京工業大学)

委員：栗屋信義(シャープ)、井上 實(日本酸素)、太田与洋(東京エレクトロ)、岡田 修(アルパ)、岡野晴雄(アプライドマテリアルズジャパン)、久保田正文(松下電器)、久保高行(三菱住友シリコン)、小林 清輝(ルネサステクノロジ)、寒川誠二(東北大学)、須田良幸(東京農工大学)、嶋 昇平(荏原製作所)、鈴木久満(日本電気)、高崎金剛(富士通)、谷口研二(大阪大学)、中田鍊平(東芝セミコンダクタ)、野澤 悟(ソニー)、橋本 晃(東京応化)、林 俊雄(アルバック)、深瀬健二(三洋電機)、福澤 健(住友電気工業)、鳳 紘一郎(東京大学)、堀池靖浩(東京大学)、本間敬之(早稲田大学)、榊井 積(信越半導体)、森 晋(ニコン)、茂庭昌弘(ルネサステクノロジ)、山口美則(鐘淵化学工業)、吉丸正樹(沖電気)、海外委員：吉田 誠 (Samsung)